



Vários tipos de produção são suportados por meio da montagem de alta velocidade e altamente eficiente de componentes de forma ímpar.

NPM-TT2

A colocação de alta velocidade e altamente eficiente de componentes de forma ímpar é obtida organizando os alimentadores de bandeja na frente/atrás, contribuindo assim para a melhoria total da produtividade

Key Features

Conectividade direta com NPM-D3 / W2

Cabeçotes de colocação (cabeçote leve de 8 bicos, cabeçote de 3 bicos V2)

Especificações da unidade de alimentação selecionável e configurável

Adoção de câmera de reconhecimento multimodo

Suporte de montagem alternativo e independente

NPM-TT2

<https://latam.connect.panasonic.com/br/pt/npm-tt2>

PCB dimensions (mm)	PC size Single-lane mode:L 50 mm × W50 mm ~ L 510 mm × W 590 mm Dual-lane mode:L 50 mm × W50 mm ~ L 510 mm × W 300 mm M size Single-lane mode:L 50 mm × W50 mm ~ L 510 mm × W 510 mm Dual-lane mode:L 50 mm × W50 mm ~ L 510 mm × W 260 mm
Placement Head	8 / 3
Placement Head max Speed	18 000 cph (0.20 s / chip)
Placement Head Placement Accuracy (Cpk_{≥1})	±40μm / chip
Component dimensions	0402chip ~ L 120 × W90 × T 30 or L 150 × W 25 × T 30
PCB Transfer Lane	Single/Dual
Component Supply	Taping/Stick/Tray
Maximum number of components supply (Tape Width: 4 mm, 8 mm calculation)	120
Number of heads	2
Footnote Description	*The above specifications are standard specifications. Please contact us for details, as the product may differ depending on usage conditions, etc.